



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 50

行间距: 2 mm [.078 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

行数: 10

产品特性

产品类型特性

背板模块类型	左
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩

结构特性

可堆叠	否
信号位置数量	50
背板架构	传统背板
位数	50
行数	10
列数	5
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

信号特征

每列的差分对数量	3
----------	---

主体特性

导针种类	通用电源模块
------	--------

屏蔽材料	磷青铜
------	-----

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
------	----

端子接合区域电镀材料厚度	.5 μm [19.68 μin]
--------------	--

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	双梁, 双梁
---------	--------

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----

端子额定电流 (最大值)	1.15 A
--------------	--------

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.1 mm[.083 in]
-----------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

导轨硬件	不带
------	----

接合固定	不带
------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
------------	-----------

接合对准	带有
------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

有带罩的边数	0
--------	---

外壳材料	LCP (液晶聚合物)
------	-------------

中心线 (间距)	2 mm[.079 in]
----------	---------------

尺寸

连接器长度	22.86 mm[.899 in]
-------	-------------------

连接器高度	11.95 mm[.47 in]
-------	------------------

连接器宽度	28.67 mm[.831 in]
-------	-------------------

PCB 厚度 (建议)	1.4 mm[.055 in]
-------------	-----------------

PCB 孔直径	.05 mm
---------	--------

行间距	2 mm[.078 in]
-----	---------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Z-PACK HS3](#)



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5120875-1_O1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5120875-1_O1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5120875-1_O1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本